



京鼎精密科技股份有限公司

2025第三季法人說明會

2025/12/23

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鍾曉佩

副處長

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

徐朝煌

協理

黃俊凱

協理

鍾曉佩

副處長



劉揚偉

董事長



邱耀銓

執行長

主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

全球佈局 區域製造



2001
成立

2015
上市(3413 TT)

3,978 員工人數
截至2025/11/28

NT\$ 10.85億 股本
截至2025/9/30

NT\$ 325.54億 市值
截至2025/11/28

2025年前三季營收
NT\$156.14億
+34.0% YoY

2025年前三季毛利率
25.6%
-0.7ppts YoY

2025年前三季每股盈餘
NT\$ 16.22元
-8.8% YoY

全球佈局



生產基地：橫跨 4 區 7 廠，羅勇廠 25Q1 啟用，春武里廠 26Q1 試產

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



上海松江廠



江蘇昆山廠



新產品開發中心

美國矽谷廠



美國加州/德州/亞利桑那州辦公室



泰國春武里廠(26H1)



泰國羅勇廠(25Q1)



- ：營運製造據點-台灣-竹南/上海/江蘇
- ：營運製造據點(新增)-泰國
- ：新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA
- ：銷售服務與國際採購據點-台灣/江蘇/加州/德州/亞利桑那州



財務報告



綜合損益表



單位：新台幣百萬元	3Q25		2Q25		QoQ%	3Q24		YoY%	YTD 3Q25		YTD 3Q24		YoY%
營業收入淨額	5,542	100.0%	5,203	100.0%	6.5%	4,612	100.0%	20.2%	15,614	100.0%	11,655	100.0%	34.0%
營業毛利	1,304	23.5%	1,358	26.1%	-2.6 pts	1,234	26.8%	-3.3 pts	3,992	25.6%	3,061	26.3%	-0.7 pts
營業費用	(568)	(10.2%)	(481)	(9.2%)		(424)	(9.1%)		(1,502)	(9.6%)	(1,163)	(10.0%)	
營業利益	736	13.3%	877	16.9%	-3.6 pts	810	17.7%	-4.4 pts	2,490	16.0%	1,898	16.3%	-0.3 pts
營業外損益	152	2.7%	(456)	(8.8%)		(102)	(2.2%)		(220)	(1.4%)	302	2.6%	
稅前淨利	888	16.0%	421	8.1%	+7.9 pts	708	15.5%	+0.5 pts	2,270	14.6%	2,200	18.9%	-4.3 pts
本期淨利	699	12.6%	391	7.5%	+5.1 pts	582	12.6%	-	1,813	11.6%	1,824	15.6%	-4.0 pts
歸屬予：													
母公司股東	667		369		81.0%	582		14.6%	1,760		1,824		-3.5%
基本每股盈餘(元)	6.10		3.41		2.69	5.52		0.58	16.22		17.79		(1.57)
加權平均流通在外股數(百萬股)	109.35		108.17			105.42			108.48		102.48		

資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	3Q25		2Q25		3Q24	
現金及流動金融資產	6,600	25%	7,543	29%	9,613	45%
應收帳款	2,113	8%	1,815	7%	1,703	8%
存貨	4,151	16%	3,904	15%	3,449	16%
長期投資	343	1%	438	2%	440	2%
不動產、廠房及設備	9,287	35%	8,016	31%	5,012	24%
無形資產	2,423	9%	2,425	9%	15	1%
資產總計	26,732	100%	26,062	100%	21,506	100%
應付帳款	1,669	6%	1,359	5%	1,533	7%
銀行借款	3,264	12%	2,829	11%	1,782	8%
應付公司債	95	0%	222	1%	586	3%
流動負債	7,137	27%	7,311	28%	4,622	21%
負債總計	9,493	36%	10,077	39%	7,333	34%
股東權益總計	17,239	64%	15,985	61%	14,173	66%
重要財務指標						
平均收現天數	33		32		29	
平均銷貨天數	98		99		100	
平均付現天數	40		38		39	
淨營運現金週期天數	91		93		90	
流動比率(倍)	1.89		1.88		3.26	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	YTD 3Q25	YTD 3Q24
期初現金	7,527	6,956
營運活動之現金流入	1,062	1,179
資本支出	(2,618)	(1,451)
現金股利	(1,592)	(1,173)
定期存款	747	720
銀行借款淨變動	1,326	111
企業合併現金淨支付數	(1,263)	-
投資與其他	(71)	319
期末現金	5,118	6,661
自由現金流量*	(1,556)	(272)

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望



營收趨勢



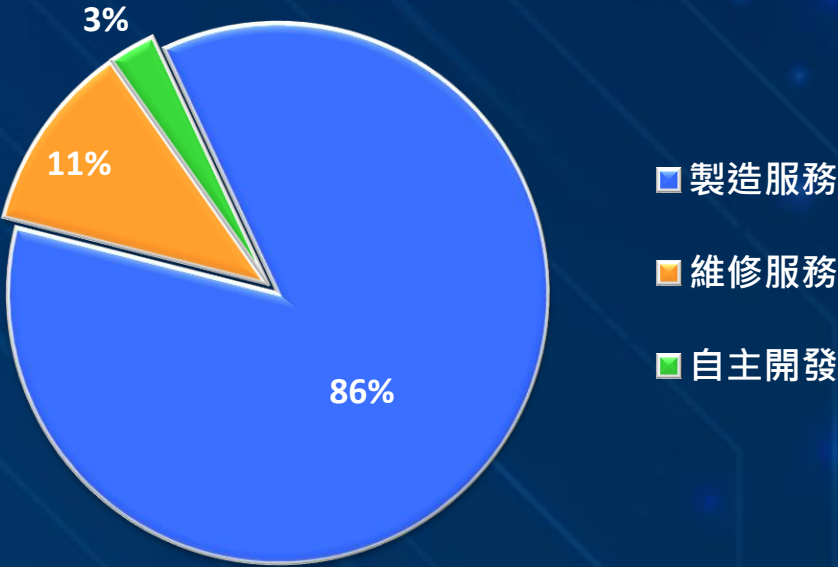
■ Q3 營收 55.42 億元，YoY +20.2%、QoQ +6.5%，連六季成長、創單季新高

■ 前三季營收 156.14 億元，YoY +34%，創同期新高



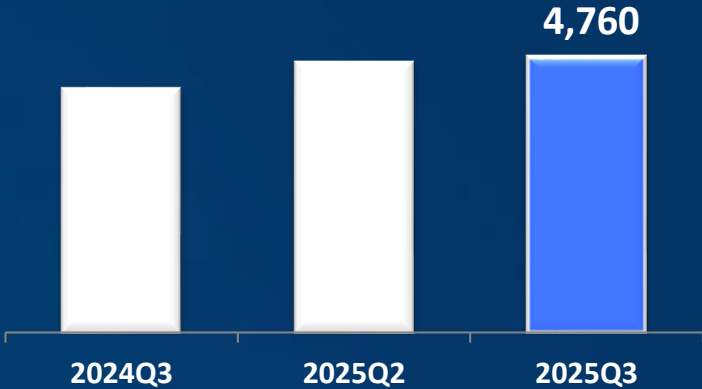
註：製造服務=半導體製程設備關鍵模組、零部件與備品耗材製造
維修服務=半導體與航太維修
自主開發=半導體自動化設備

2025年第三季銷售分析-業務別



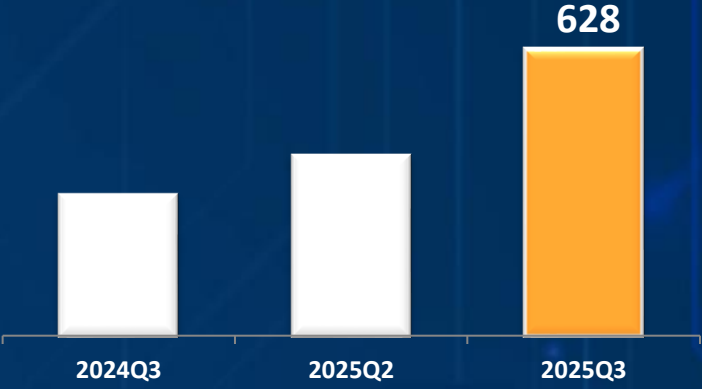
製造服務
+2.4% QoQ
+13.4% YoY

單位：台幣百萬



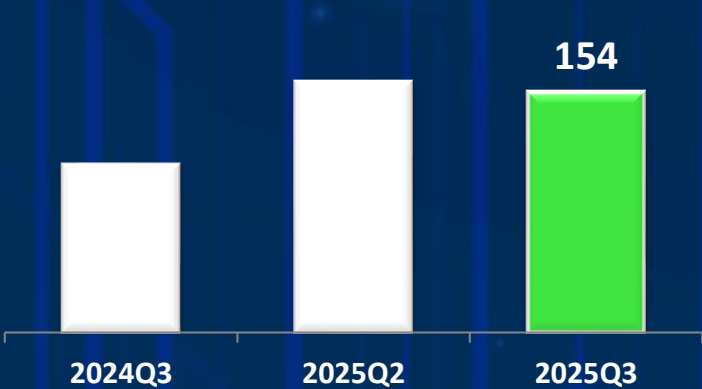
維修服務
+60.0% QoQ
+104.5% YoY

單位：台幣百萬



自主開發
-4.3% QoQ
+43.2% YoY

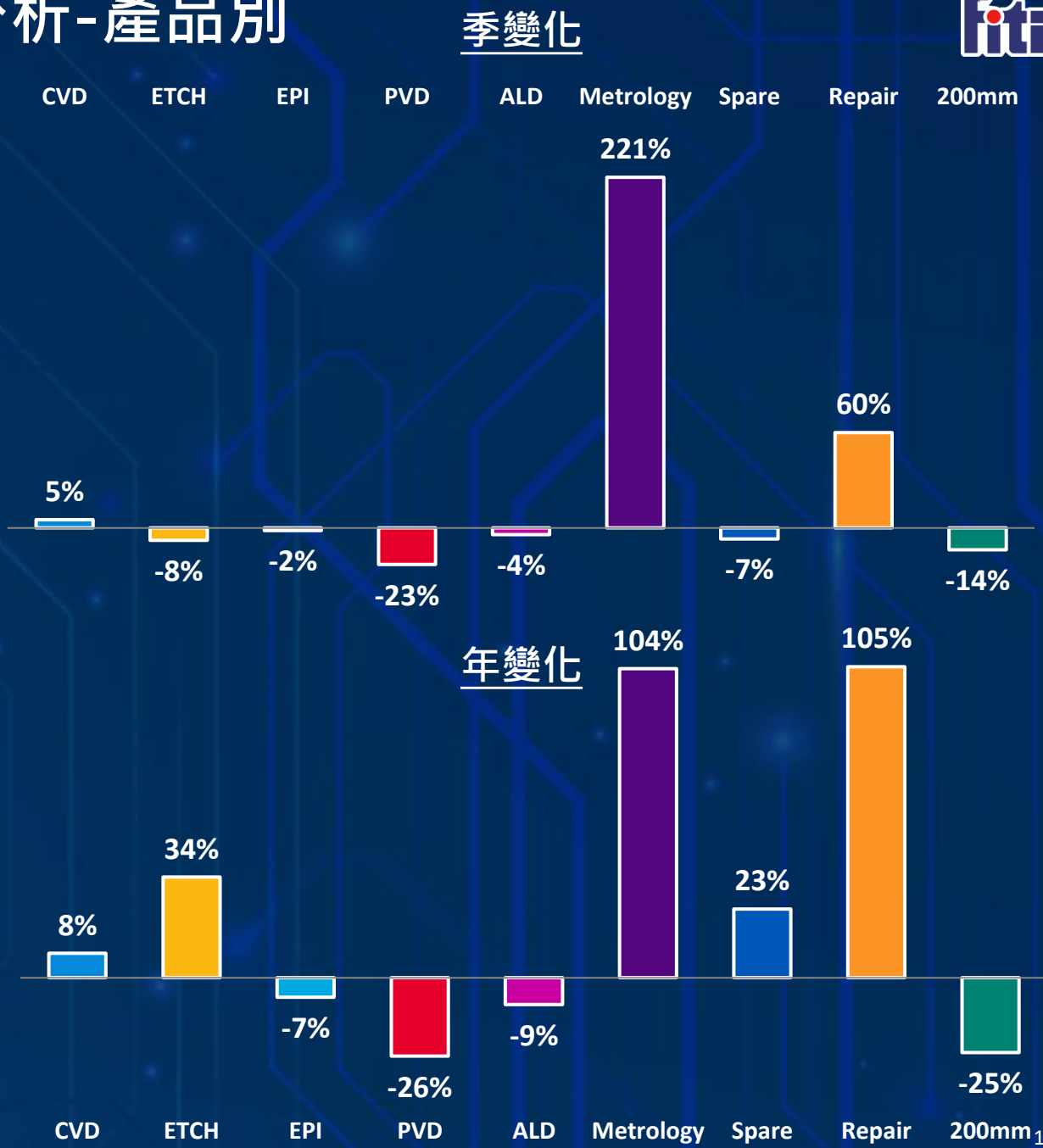
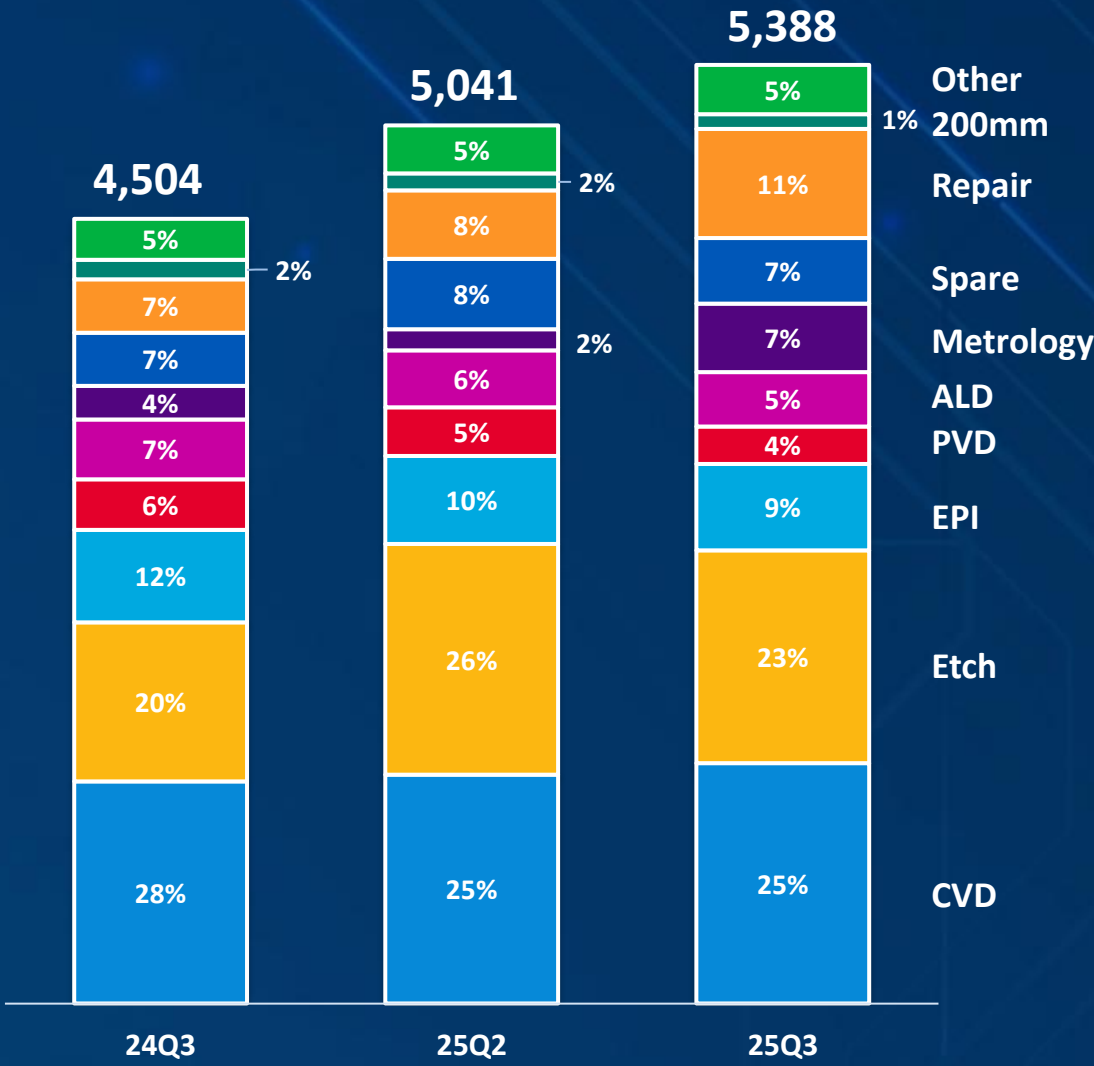
單位：台幣百萬



2025年第三季製造及維修服務銷售分析-產品別



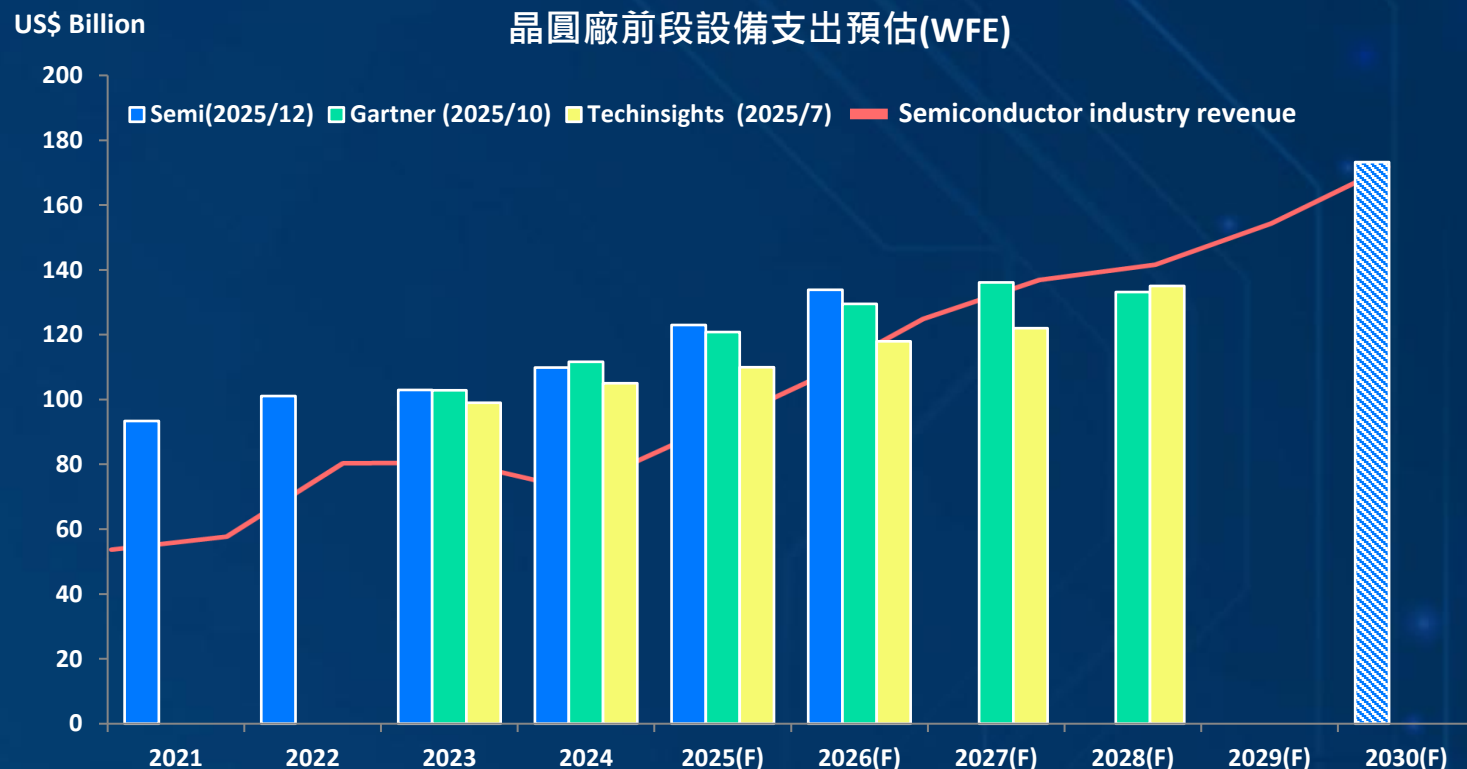
單位：台幣百萬



產業趨勢



- 2025 年 WFE 市場預期成長 5%–12%：AI 與 HPC 應用帶動先進製程需求強勁，惟中國市場放緩及消費性、工控與車用需求疲弱，抵銷部分成長動能。
- 2026 年 WFE 市場預估成長 7%–9%；受惠於先進製程升級（GAA、HBM）與先進封裝擴產，設備安裝時程集中於下半年，市場動能可望於 2026 年下半年轉強，並於 2027 年進一步放大。
- 長期展望：AI 應用擴大、先進製程持續升級，加上全球供應鏈區域化推進，帶動半導體設備需求進入結構性成長。



WFE(\$B)	2024	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)
Semi (2025/12)	110	123	134		
YoY	7%	12%	9%		
Gartner (2025/10)	112	121	130	136	133
YoY	9%	8%	7%	5%	-2%
TechInsights (2025/7)	105	110	118	122	135
YoY	6%	5%	7%	3%	11%

Source:Semi/Gartner/TechInsights

2025年第四季展望





Onto Innovation

傑出供應商獎



TCSA

台灣企業永續報告書銀獎

春武里新廠正式啟用



春武里新廠於 11/11 正式啟用，2026 年第一季進入試產



■ 營運成果

- 第三季營收創單季新高，前三季累計亦創歷史同期新高；惟第二季匯兌損失影響前三季獲利。
- 春武里廠 11 月啟用，2026 年第一季試產，海外製造布局持續完善，強化公司全球供應鏈彈性。
- 客戶合作與永續治理表現，持續獲國際客戶與外部機構肯定。

■ 營運展望

- 2025Q4 至 2026 上半年的短期需求放緩，主要反映客戶提前備貨與晶圓廠設備安裝時程調整，客戶下單態度亦相對謹慎。
- 隨著先進製程與高階記憶體擴產於 2026 年下半年放量，設備投資動能可望回溫，帶動公司營收在下半年回升，2026 年營收表現維持穩健。
- 短期毛利承壓，在營收規模擴大與營運效率提升的情況下，有望支撐獲利表現。
- AI 與 HPC 應用擴大帶動先進邏輯、高階記憶體與先進封裝同步擴產；隨製程層數增加與複雜度上升，蝕刻、薄膜沉積與檢測等關鍵設備需求提高，半導體設備需求進入結構性成長。

Q&A

The background of the slide is a dark blue gradient. In the center, there is a glowing blue circuit board. The board is composed of numerous white lines representing circuit traces, which are illuminated with a bright blue light. A central square area of the board is particularly bright, emitting a strong blue glow. The overall effect is a high-tech, digital aesthetic.



Thank you

